

2017-2023年中国半导体行业市场研究及发展前景 预测报告

报告大纲

一、报告简介

华经情报网发布的《2017-2023年中国半导体行业市场研究及发展前景预测报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.huaon.com/detail/320011.html>

报告价格：电子版: 9000元 纸介版：9000元 电子和纸介版: 9200元

订购电话: 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱: kf@huaon.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

中国是全球最大的电子产品制造基地。近年来全球半导体行业发展速度趋缓，唯独中国一枝独秀，多年来市场需求均保持快速增长。中国半导体市场需求占全球比例持续攀升，已由2003年的18.5%提升到2014年的56.6%，中国已成为全球半导体消费的中坚力量。

2003-2014年全球半导体市场需求各地区占比

数据来源：公开数据整理 2015年全球地区半导体市场规模及增长率

数据来源：公开数据整理

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 2014-2016年全球半导体产业发展分析

1.1 2014-2016年世界半导体市场总体分析

1.1.1 产业发展历程

1.1.2 全球市场规模

1.1.3 市场竞争格局 2014年全球十大半导体设备商市场份额

数据来源：公开数据整理

1.1.4 行业整并形势

1.1.5 未来发展趋势

1.2 2014-2016年美国半导体市场发展分析

1.2.1 市场发展规模

1.2.2 行业并购热潮

1.2.3 政策助力发展

1.2.4 产业发展战略

1.2.5 未来发展前景

1.3 2014-2016年韩国半导体市场发展分析

1.3.1 全球产业地位

1.3.2 市场发展动力

1.3.3 竞争形势分析

1.3.4 产业创新模式

1.3.5 设备产业战略

1.3.6 未来市场发展

1.4 2014-2016年日本半导体市场发展分析

1.4.1 行业发展历史

1.4.2 产业发展现状

1.4.3 市场竞争格局

1.4.4 行业发展经验

1.5 2014-2016年其他国家半导体产业发展分析

1.5.1 英国

1.5.2 德国

1.5.3 印度

第二章 中国半导体产业发展环境分析

2.1 政策环境

2.1.1 智能制造政策

2.1.2 集成电路政策

2.1.3 半导体产业规划

2.1.4 “互联网+”政策

2.2 经济环境

2.2.1 国民经济运行状况

2.2.2 工业经济增长情况

2.2.3 固定资产投资情况

2.2.4 经济转型升级形势

2.2.5 宏观经济发展趋势

2.3 社会环境

2.3.1 互联网加速发展

2.3.2 智能产品的普及

2.3.3 科技人才队伍壮大

2.4 技术环境

2.4.1 忆阻器的研发

2.4.2 激光连接研发

2.4.3 可编程的层级

2.4.4 石墨烯的推动

2.4.5 印刷电路发展

2.4.6 无线芯片技术

第三章 2014-2016年中国半导体行业发展分析

3.1 中国半导体产业发展综述

3.1.1 行业基本概述

3.1.2 行业发展意义

3.1.3 市场形势分析

3.1.4 产业发展基础

3.1.5 上游行业发展

3.2 2014-2016年中国半导体市场发展规模

3.2.1 产业发展规模

3.2.2 市场规模现状

3.2.3 销售市场规模

3.2.4 产业资金投资

3.3 2014-2016年中国半导体技术研发进展

3.3.1 技术发展现状

3.3.2 技术发展方向

3.3.3 技术发展趋势

3.4 中国半导体行业发展问题分析

3.4.1 产业发展困境

3.4.2 开发速度放缓

3.4.3 市场垄断困境

3.5 中国半导体市场发展应对策略

3.5.1 企业发展战略

3.5.2 突破垄断策略

3.5.3 加强技术研发

第四章 2014-2016年中国半导体行业上游半导体材料发展分析

4.1 半导体材料相关概述

4.2 2014-2016年全球半导体材料发展状况

4.2.1 市场发展回顾

4.2.2 市场现状分析

4.2.3 行业研发动态

4.3 2014-2016年中国半导体材料行业运行状况

4.3.1 产业发展特点

4.3.2 行业销售规模

4.3.3 市场格局分析

4.3.4 产业转型升级

4.3.5 行业成果分析

4.4 主要半导体材料市场发展分析

4.4.1 硅片

4.4.2 靶材

4.4.3 掩膜版

4.4.4 光刻胶

4.4.5 电子气体

4.4.6 封装材料

4.4.7 高纯化学试剂

4.4.8 化学机械研磨

4.5 半导体材料行业存在的问题及发展对策

4.5.1 行业发展滞后

4.5.2 产品同质化严重

4.5.3 供应链不完善

4.5.4 产业创新不足

4.5.5 行业发展建议

4.6 半导体材料产业未来发展前景展望

4.6.1 行业发展趋势

4.6.2 行业需求分析

4.6.3 行业前景分析

第五章 2014-2016年中国半导体行业中游集成电路发展分析

5.1 2014-2016年中国集成电路发展总况

5.1.1 全球市场规模

5.1.2 产业政策推动

5.1.3 主要应用市场

5.1.4 市场规模现状

5.2 2014-2016年中国IC设计产业发展分析

5.2.1 产业发展历程

5.2.2 市场发展现状

5.2.3 市场竞争格局

5.2.4 企业专利情况

5.2.5 国内外差距分析

5.3 2014-2016年中国晶圆制造行业发展分析

5.3.1 晶圆制造工艺

5.3.2 晶圆加工技术

5.3.3 国外发展模式

5.3.4 国内发展模式

5.3.5 企业竞争现状

5.3.6 市场布局分析

5.3.7 产业面临挑战

5.4 2014-2016年中国芯片封装测试行业发展分析

5.4.1 封装技术介绍

5.4.2 芯片测试原理

5.4.3 主要测试分类

5.4.4 封装市场现状

5.4.5 封测竞争格局

5.4.6 发展面临问题

5.4.7 技术发展趋势

5.5 中国集成电路产业发展的问题及对策

5.5.1 发展面临问题

5.5.2 发展对策分析

5.5.3 产业突破方向

5.5.4 “十三五”发展建议

5.6 集成电路行业未来发展趋势及潜力分析

5.6.1 全球市场趋势

5.6.2 国内行业趋势

5.6.3 行业机遇分析

5.6.4 市场规模预测

第六章 2014-2016年中国半导体行业中游半导体设备发展分析

6.1 2014-2016年半导体设备行业发展分析

6.1.1 产业链位置

6.1.2 产业发展地位

6.1.3 市场发展主体

6.2 2014-2016年全球半导体设备市场发展形势

6.2.1 全球销售规模

6.2.2 行业投资规模

6.2.3 重点设备企业

6.2.4 发展潜力分析

6.3 2014-2016年中国半导体设备市场发展现状

6.3.1 发展形势分析

6.3.2 市场规模分析

6.3.3 销售市场格局

6.3.4 重点企业发展

6.3.5 巨大替代空间

6.4 半导体设备核心工艺发展分析

6.4.1 光刻机

6.4.2 刻蚀机

6.4.3 化学气相沉积

6.5 中国半导体设备企业面临的发展障碍

6.5.1 技术壁垒

6.5.2 资金壁垒

6.5.3 产业链壁垒

6.6 中国半导体设备市场投资机遇分析

6.6.1 行业投资机会分析

6.6.2 建厂加速拉动需求

6.6.3 国内实现进口替代

6.6.4 产业政策扶持发展

第七章 2014-2016年中国半导体行业下游应用领域发展分析

7.1 物联网

7.1.1 产业链的地位

7.1.2 市场规模现状

7.1.3 关键技术分析

7.1.4 市场并购动态

7.1.5 未来发展前景

7.2 智能手机

7.2.1 市场发展规模

7.2.2 市场竞争形势

7.2.3 半导体技术应用

7.2.4 助推半导体发展

7.2.5 发展趋势分析

7.3 医疗设备

7.3.1 市场发展规模

7.3.2 半导体器件发展

7.3.3 半导体技术研发

7.3.4 未来发展前景

7.4 车用半导体

7.4.1 市场发展形势

7.4.2 市场产值规模

7.4.3 整体竞争态势

7.4.4 车联网拉动需求

7.4.5 行业并购加速

7.5 半导体照明

7.5.1 产品发展优势

7.5.2 市场发展形势

7.5.3 全球市场现状

7.5.4 中国产业发展

7.5.5 产品价格走势

7.5.6 未来发展前景

第八章 2014-2016年中国半导体产业区域发展分析

8.1 中国半导体产业区域布局分析

8.2 2014-2016年京津渤海区域半导体产业发展分析

8.2.1 区域的发展总况

8.2.2 半导体照明产业

8.2.3 北京市场的发展

8.2.4 石家庄产业发展

8.2.5 大连的产业现状

8.3 2014-2016年长三角地区半导体产业发展分析

8.3.1 区域市场发展形势

8.3.2 产业格局发展成熟

8.3.3 上海打造产业集聚地

8.4 2014-2016年珠三角地区半导体产业发展分析

8.4.1 区域产业发展现状

8.4.2 深圳产业发展现状

8.4.3 东莞建成产业基地

8.5 2014-2016年中西部地区半导体产业发展分析

8.5.1 区域市场发展现状

8.5.2 武汉投建产业基地

8.5.3 重庆产业发展战略

8.5.4 西安半导体产业发展

第九章 2014-2016年国外半导体产业重点企业经营分析

9.1 英特尔

9.1.1 企业发展概况

9.1.2 经营效益分析

9.1.3 半导体业务发展

9.1.4 企业业务投资

9.1.5 转型发展战略

9.2 三星

9.2.1 企业发展概况

9.2.2 经营效益分析

9.2.3 半导体业务发展

9.2.4 市场竞争实力

9.2.5 企业发展战略

9.3 高通公司

9.3.1 企业发展概况

9.3.2 经营效益分析

9.3.3 半导体业务发展

9.3.4 收购动态分析

9.3.5 未来发展战略

9.4 海力士

9.4.1 企业发展概况

9.4.2 经营效益分析

9.4.3 企业业务发展

9.4.4 厂房建设动态

9.4.5 对华战略分析

9.5 德州仪器

9.5.1 企业发展概况

9.5.2 经营效益分析

9.5.3 产销模式变革

9.5.4 企业发展动态

9.5.5 市场发展战略

9.6 东芝

9.6.1 企业发展概况

9.6.2 经营效益分析

9.6.3 企业动态分析

9.6.4 产品研发进展

9.6.5 未来发展战略

9.7 美国美光

9.7.1 企业发展概况

9.7.2 经营效益分析

9.7.3 企业动态分析

9.7.4 企业发展战略

9.8 博通公司

9.8.1 企业发展概况

9.8.2 经营效益分析

9.8.3 企业收购动态

9.8.4 产品研发进展

9.8.5 未来发展前景

9.9 英飞凌

9.9.1 企业发展概况

9.9.2 经营效益分析

9.9.3 半导体产业发展

9.9.4 企业收购动态

9.9.5 未来发展战略

第十章 2014-2016年中国半导体产业重点企业经营分析

10.1 展讯

10.1.1 企业发展概况

10.1.2 经营效益分析

10.1.3 新品研发进展

10.1.4 产品应用情况

10.1.5 未来发展前景

10.2 台积电

10.2.1 企业发展概况

10.2.2 经营效益分析

10.2.3 产品研发进程

10.2.4 工艺技术优势

10.2.5 未来发展规划

10.3 日月光

10.3.1 企业发展概况

10.3.2 经营效益分析

10.3.3 企业合作动态

10.3.4 汽车电子封测

10.4 联华电子

10.4.1 企业发展概况

10.4.2 经营效益分析

10.4.3 产品研发进展

10.4.4 市场布局规划

10.4.5 未来发展前景

10.5 华虹

10.5.1 企业发展概况

10.5.2 经营效益分析

10.5.3 企业发展形势

10.5.4 产品发展方向

10.5.5 未来发展前景

第十一章 中国半导体产业投资分析

11.1 产业投资现状

11.2 投资并购动态

11.2.1 索尼

11.2.2 软银

11.2.3 ARM

11.2.4 Qorvo

11.2.5 英飞凌

11.2.6 微芯科技

11.2.7 四维图新

11.2.8 福建宏芯

11.2.9 赛普拉斯

11.2.10 意法半导体

11.3 重点投资领域

11.3.1 存储

11.3.2 生产封测

11.3.3 模拟芯片

11.3.4 生产设备

11.3.5 数字芯片SOC

11.4 投资风险分析

11.4.1 宏观经济风险

11.4.2 环保相关风险

11.4.3 产业结构性风险

11.5 融资策略分析

11.5.1 项目包装融资

11.5.2 高新技术融资

11.5.3 BOT项目融资

11.5.4 IFC国际融资

11.5.5 专项资金融资

第十二章 中国半导体产业未来发展前景及趋势分析

12.1 中国半导体产业市场前景分析

12.1.1 市场前景分析

12.1.2 政策助力发展

12.1.3 晶圆设备需求增长

12.1.4 产业“十三五”规划

12.2 中国半导体市场未来发展趋势预测

12.2.1 产业发展趋势

12.2.2 未来发展方向

12.2.3 芯片制造基础提升

12.2.4 国产设备加速替换

图表目录：

图表1 1988年全球半导体企业销量top20

图表2 2003-2014年全球半导体市场需求各地区占比

图表3 2015-2017年全球各地区半导体市场规模及增长率

图表4 2015年全球8寸晶圆产能分布

图表5 2015年全球12寸晶圆产能分布

图表6 2014年全球十大半导体设备商市场份额

图表7 2014年全球半导体下游应用结构

图表8 2011-2016年日本半导体设备BB值

图表9 2011-2016年北美半导体设备BB值

图表10 2014-2018年全球半导体的资本支出和设备投资规模

图表11 2014-2015年各地区半导体材料市场规模

图表12 2013-2016年全球晶圆制造与封装材料市场规模

图表13 2016年全球半导体企业销量top20

图表14 韩国半导体产业政策（一）

图表15 韩国半导体产业政策（二）

图表16 美国、韩国合作研发的半导体技术

图表17 韩国知识经济部支持三星电子和Hynix核心半导体设备开发

图表18 韩国20个“名不见经传”的半导体企业。

图表19 日本半导体产业的两次产业转移

图表20 日本半导体产业发展历程

图表21 VLSI项目实施情况

图表22 日本政府相关政策

图表23 1989半导体芯片市场份额

图表24 1990年全球十大半导体企业

图表25 韩国DRAM技术完成对日美的赶超化

图表26 DRAM市场份额变化

图表27 日本三大半导体开发计划的关联

图表28 集成电路产业链

图表29 2015半导体材料生产份额

图表30 半导体材料市场消费份额

图表31 2014年半导体材料行业日本份额占比

图表32 2014年全球半导体消费市场分布

图表33 半导体产业链

图表34 半导体材料分类产值

图表35 半导体材料份额比例

图表36 全球硅片市场份额

图表37 信越化学产品分类

图表38 1960-1970年日本有机硅产量

图表39 信越化学竞争策略

图表40 日本有机硅产量

图表41 日本的“硅类高分子材料研究开发基本计划”进度表

图表42 全球主要光罩生产商产品布局

图表43 半导体材料份额比例

图表44 全球硅片市场份额

图表45 2005-2012年凸版印刷主要并购事件

图表46 2000-2009年凸版印刷主要并购事件

图表47 2014-2019年全球OLED面板市场预期增长情况

图表48 2015年全球半导体光刻胶市场分布

图表49 半导体企业经营模式发展历程

图表50 IDM商业模式

图表51 Fabless+Foundry模式

图表52 智能制造系统架构

图表53 智能制造系统层级

图表54 MES制造执行与反馈流程

图表55 云平台体系架构

图表56 2011-2015年国内生产总值及其增长速度

图表57 2015年年末人口数及其构成

图表58 2011-2015年城镇新增就业人数

图表59 2011-2015年全员劳动生产率

图表60 2015年居民消费价格月度涨跌幅度

图表61 2015年居民消费价格比2014年涨跌幅度

图表62 2015年新建商品住宅月同比价格上涨、持平、下降城市个数变化情况

图表63 2011-2015年全国一般公共预算收入

图表64 2011-2015年年末国家外汇储备

图表65 2011-2015年粮食产量

图表66 2011-2015年社会消费品零售总额

图表67 2011-2015年货物进出口总额

图表68 2015年货物进出口总额及其增长速度

图表69 2015年主要商品出口数量、金额及其增长速度

图表70 2015年主要商品进口数量、金额及其增长速度

图表71 2015年对主要国家和地区货物进出口额及其增长速度

图表72 2015年外商直接投资（不含银行、证券、保险）及其增长速度

图表73 2015年对外直接投资额（不含银行、证券、保险）及其增长速度

图表74 2015年各种运输方式完成货物运输量及其增长速度

图表75 2015年各种运输方式完成旅客运输量及其增长速度

图表76 2011-2015年快递业务量及增长速度

图表77 2011-2015年年末固定互联网宽带接入用户和移动宽带用户数

图表78 2015年年末全部金融机构本外币存贷款余额及其增长速度

图表79 2014-2015年各月累计主营业务收入与利润总额同比增速

图表80 2014-2015年各月累计利润率与每百元主营业务收入中的成本

图表81 2015年规模以上工业企业主要财务指标

图表82 2015年规模以上工业企业经济效益指标

图表83 2015年规模以上工业企业主要财务指标（分行业）

图表84 2014-2015年固定资产投资（不含农户）同比增速

图表85 2015-2016年固定资产投资（不含农户）同比增速

图表86 2015-2016年固定资产投资到位资金同比增速

图表87 半导体是自主可控与信息安全的重要支柱

图表88 2013-2016年出台的集成电路政策支持文件

图表89 国家支持政策搭建产业环境

图表90 北美半导体BB值自2015年12月起连续7个月超过荣枯线

图表91 《国家集成电路产业发展推进纲要》的产业发展目标

图表92 《国家集成电路产业发展推进纲要》的主要任务和发展重点

图表93 半导体各子行业固定资产比例

图表94 半导体各子行业毛利率、净利率对比

图表95 半导体产业链

图表96 2011-2015年我国集成电路产业固定资产投资

图表97 2011-2015年我国集成电路创新产品和技术获奖情况

图表98 2015我国半导体下游应用结构

图表99 2012-2018年平均每辆汽车半导体成本

图表100 2010-2016年中国汽车电子市场规模

图表101 2012-2015年我国云计算市场规模

图表102 2016-2018年我国云计算市场规模预测

图表103 2012-2015年我国可穿戴设备市场规模

图表104 2016-2018年我国可穿戴设备市场规模预测

图表105 2011-2015年中国半导体制造材料市场规模

图表106 中国半导体制造材料市场规模

图表107 2000-2017年全球半导体市场规模及增速

图表108 2007-2015年全球半导体资本支出情况

图表109 2014-2016年台积电出货量

图表110 2012-2016年台积电产能利用率

图表111 2015年国家集成电路产业投资基金投资结构

图表112 大基金投资半导体全产业链

图表113 2013-2015年中国集成电路产业并购事件

图表114 各地方基金设立和投资情况引导社会资本投入

图表115 MoreMoore&MoreThanMoore

图表116 台积电晶圆制程技术路线

图表117 英特尔晶圆制程技术路线

图表118 晶圆制造新制程的研发成本

图表119 芯片封装技术发展路径

图表120 芯片封装技术发展趋势

图表121 TSV3DIC封装结构

图表122 IC制造3D封装技术的关键材料挑战

图表123 集成电路产业链流程图以及配套材料

图表124 2012-2013年全球半导体材料市场情况

图表125 2013-2014年全球半导体材料市场情况

图表126 全球半导体前道各材料市场比重

图表127 2013-2016年全球半导体前道材料市场预测

图表128 2006-2015年全球半导体材料市场销售额

图表129 2006-2015年各国半导体材料市场销售额

图表130 2000-2015年全球半导体晶圆制造材料与封装材料市场销售额

图表131 2000-2015年全球半导体与半导体材料市场销售额

图表132 中国12寸晶圆厂

图表133 2013-2020年中国大陆12寸大硅片需求统计及预测

图表134 半导体硅片种类占比

图表135 2005-2020年全球各类尺寸半导体硅片出货量统计与预测

图表136 全球晶圆制造用材料市场规模占比

图表137 2013-2016年全球半导体硅片市场规模

图表138 半导体大硅片生产工艺流程

图表139 2013年全球半导体硅片市场份额

图表140 2006-2015年半导体硅片企业财务数据

图表141 中国半导体硅片供应商

图表142 中国企业开发生产300mm大硅片的机会

图表143 溅射靶材工作原理

图表144 按照不同的分类方法

图表145 按照不下游应有领域不同分类

图表146 全球前7大溅射靶材制造商

图表147 高纯溅射靶材产业链

图表148 高纯溅射靶材产业链

图表149 2010-2016年中国半导体芯片用溅射靶材市场规模及预测情况

图表150 掩膜版工作原理

图表151 2013-2017年全球光罩市场规模

图表152 2014年掩膜版市场分类

图表153 光刻胶的成分

图表154 光刻胶在集成电路制造工艺中的应用

图表155 正性光刻胶与负性光刻胶

图表156 光刻胶主要应用生产商情况

图表157 2009-2014年全球光刻胶市场需求规模

图表158 2014年全球光刻胶下游应用分布

图表159 2007-2014年国内光刻胶市场规模

图表160 中国半导体及平板显示主要光刻胶产品的市场空间

图表161 全球光刻胶市场份额

图表162 中国光刻胶厂商

图表163 我国光刻胶国产化现状

图表164 光刻技术与集成电路技术的关系

图表165 新型光刻技术

图表166 中国光刻胶技术发展路线图

图表167 半导体气体分类

图表168 国内电子气体竞争格局

图表169 国内特种气体主要生产企业

图表170 特气在半导体领域的应用

图表171 2013-2016年全球晶圆制造用气体市场规模

图表172 2011-2015年我国晶圆制造用气体市场规模

图表173 我国电子特种气体市场份额

图表174 我国特气企业

图表175 半导体制造工序与试剂

图表176 通用湿电子化学品的种类与需求占比

图表177 功能湿电子化学品的种类与需求占比

图表178 2013-2016年全球半导体湿化学品市场规模

图表179 2011-2015年我国半导体湿化学品市场规模

图表180 2014年国内晶圆制造中各类湿化学品消耗量

图表181 全球湿化学品市场格局

图表182 各地区半导体材料市场规模

图表183 国内半导体晶圆用湿电子化学品主要供应商

图表184 2014年底我国湿电子化学品主要生产企业简况及实际产能统计

图表185 CMP工艺及材料

图表186 CMP原理

图表187 CMP应用技术

图表188 CMP耗材与设备市场规模

图表189 CMP材料细分市场占比

图表190 2011-2015年全球集成电路产业销售额

图表191 《国家集成电路产业发展推进纲要》发展目标

图表192 集成电路产业投资基金海外并购案例

图表193 2015年按照下游领域区分的集成电路产业销售额占比情况

图表194 2015-2016年集成电力主要应用领域的需求分析

图表195 2011-2015年全球半导体市场销售额

图表196 2011-2015年中国集成电路产业销售额

图表197 2011-2015年中国集成电路进出口额

图表198 2006-2015年全球及中国集成电路增速

图表199 IC设计的不同阶段

图表200 2015年全球各地区IC设计公司营收占比

图表201 IC产品分类图（依功能划分）

图表202 各部分IC市场份额

图表203 存储芯片的分类

图表204 2016年NANDFlash品牌厂商营收排名

图表205 2016年DRAM品牌厂商营收排名

图表206 2014年前十大模拟IC厂商销售额

图表207 2015年全球芯片设计公司销售top10

图表208 2015年中国十大集成电路设计企业专利授权情况

图表209 2015年全球十大集成电路设计企业中国专利授权情况

图表210 2015年中国十大集成电路制造企业专利授权情况

图表211 2015年全球十大集成电路制造企业专利授权情况

图表212 从二氧化硅到“金属硅”

图表213 从“金属硅”到多晶硅

图表214 从多晶硅到电子级硅

图表215 从晶柱到晶圆

图表216 光刻原理

图表217 掺杂及构建CMOS单元原理

图表218 晶圆加工制程图例

图表219 2013年全年营收前12的晶圆代工企业

图表220 2014-2015年晶圆代工厂商排名

图表221 2013-2016年三大半导体厂资本支出

图表222 2015年主要的半导体厂商

图表223 2015年中国集成电路现有产能分布图

图表224 集成电路封装

图表225 双列直插式封装

图表226 插针网格阵列封装（左）和无引线芯片载体封装（右）

图表227 鸥翼型封装（左）和J-引脚封装（右）

图表228 球栅阵列封装

图表229 倒装芯片球栅阵列封装

图表230 系统级封装和多芯片模组封装

图表231 IC测试基本原理模型

图表232 2015全球前五大封测厂市场占有率

图表233 2013-2016年世界半导体市场的统计和预测

图表234 2014年全球前20名半导体厂商收入排名预测

图表235 2010-2014年中国集成电路产业销售收入规模及增长

图表236 2015-2017年中国集成电路产业规模预测

图表237 2015-2017年中国集成电路产业各产业链销售收入

图表238 2014年中国集成电路产业各价值链结构

图表239 2015-2017年中国集成电路产业各产业链结构预测

图表240 2015-2017年中国半导体市场需求

图表241 2012-2016年全球半导体设备销售收入

图表242 2012-2016年中国半导体设备销售占比

图表243 2007-2017年中国IC制造产值占全球总产值份额

图表244 2015年中国集成电路产量

图表245 2015年中国集成电路产量统计表

图表246 2014年半导体设备厂商销售占比

图表247 半导体产业架构图

图表248 先进技术节点的生产线投资额

图表249 2015年厂商资本支出占营收比例Top5

图表250 集成电路产品前道工艺流程

图表251 集成电路产品后道工艺流程

图表252 2015年不同类型半导体制造设备销售额

图表253 2015年不同类型半导体制造设备市场份额

图表254 晶圆制造主要环节工艺及设备

图表255 封装测试主要环节工艺及设备

图表256 2012-2018年半导体设备细分市场规模变化

图表257 2014-2015年全球半导体设备市场份额

图表258 2015-2016年中国投资的晶圆生产线

图表259 2004-2016年北美半导体设备BB值

图表260 1991-2016年全球半导体设备订单与出货量

图表261 2016年各类半导体设备销售收入预测

图表262 2011-2015年主要半导体设备制造单位经济指标

图表263 2015年半导体设备分类销售情况

图表264 2015年半导体设备分类销售情况

图表265 2015年不同地区半导体制造设备销售额

图表266 2011-2015年中国大陆半导体制造设备市场份额变化

图表267 2015年中国半导体设备十强单位

图表268 2013-2014年全球十大半导体制造设备供应商

图表269 中国十大半导体制造设备供应商

图表270 1995-2014年光刻机三大巨头市占率变化及关键事件

图表271 刻蚀设备主要公司对比

图表272 不同尺度器件对应的工艺结构层数及加工步骤

图表273 2014-2017年全球主要芯片制造厂先进制程规划

图表274 先进技术节点的生产线投资额增长迅速

图表275 2014-2015年全球前十半导体厂商资本支出

图表276 国内主要半导体设备企业

图表277 2013年以来中资收购海外半导体案例

图表278 2015-2016年在华投资的晶圆生产线

图表279 2014-2020年中国半导体设备和材料市场规模

图表280 投资先进制程的IDM和Foundry厂商规模

图表281 2015-2016年国内半导体设备和材料领域的整合案例

图表282 国家支持发展的重大技术装备和产品目录——LED和集成电路装备部分

图表283 《国家集成电路产业发展推进纲要》中的集成电路产业发展目标

图表284 2011-2014年中芯国际采购和验证国产设备的情况

图表285 中芯国际北京二期（2015年35K）国产设备采购目标

图表286 半导体是物联网的核心

图表287 物联网领域涉及的半导体技术

图表288 2015-2019年物联网半导体销售额分析

图表289 2011-2016年中国智能手机市场规模增长情况

图表290 2015年中国市场智能手机出货量情况

图表291 三星DDR和LPDDR里程碑节点

图表292 LPDDR和DDR重大历史回顾

图表293 SSD和ROM领域

图表294 eMMC和UFS重要历史回顾

图表295 DDR和LPDDR区别

图表296 UFS是未来的主流存储标准

图表297 eMMC和UFS对比

图表298 eMMC和SSD关系

图表299 2014-2015年全球前十大车用半导体供应商市占率排名

图表300 2014-2020年全球LED器件市场规模及预测

图表301 2003-2016年我国功率型白光LED产业化光效

图表302 2006-2015年我国半导体照明产业各环节规模及增长率

图表303 2014-2015年全球LED灯泡零售价格情况

图表304 2014-2015年中国LED灯泡零售价格情况

图表305 2015年中国半导体四大产业区域

图表306 2015年中国半导体四大茶叶区块产值与占比

图表307 2013-2014年京津冀与长三角、珠三角LED产业规模比较

图表308 2013-2014年京津冀三地LED产业规模比较

图表309 京津冀LED企业的效益指标

图表310 京津冀地区LED照明产品的市场渗透情况

图表311 2014-2015财年英特尔综合收益表

图表312 2014-2015财年英特尔分部资料

图表313 2014-2015财年英特尔收入分地区资料

图表314 2015-2016财年英特尔综合收益表

图表315 2015-2016财年英特尔分部资料

图表316 2014-2015年三星综合收益表

图表317 2014-2015年三星收入分地区资料

图表318 2015-2016年三星综合收益表

图表319 2014-2015财年高通公司综合收益表

图表320 2014-2015财年高通公司收入分地区资料

图表321 2015-2016财年高通公司综合收益表

图表322 2015-2016财年高通公司收入分地区资料

图表323 2016年半导体企业排名

图表324 NXP主要业务

图表325 2015年新恩智浦半导体业务发展情况

图表326 汽车创新主要来自汽车电子

图表327 NXP提供完整的物联网解决方案

图表328 2014-2015年海力士综合收益表

图表329 2014-2015年海力士分部资料

图表330 2014-2015年海力士收入分地区资料

图表331 2015-2016年海力士综合收益表

图表332 2015-2016年海力士分部资料

图表333 2015-2016年海力士收入分地区资料

图表334 2014-2015年德州仪器综合收益表

图表335 2014-2015年德州仪器分部资料

图表336 2014-2015年德州仪器收入分地区资料

图表337 2015-2016年德州仪器综合收益表

图表338 2015-2016年德州仪器分部资料

图表339 2004-2015年德州仪器每年每股分红情况

图表340 德州仪器产品结构

图表341 2016年一季度全球半导体企业销售排名

图表342 德州仪器网上购买渠道

图表343 全球半导体大厂市值排名

图表344 2014-2015年东芝综合收益表

图表345 2014-2015年东芝分部资料

图表346 2014-2015年东芝收入分地区资料

图表347 2015-2016年东芝综合收益表

图表348 2015-2016年东芝分部资料

图表349 2015-2016年东芝收入分地区资料

图表350 东芝最新ADAS芯片的功能

图表351 东芝核心器件

图表352 2013-2015财年美光科技综合收益表

图表353 2013-2015财年美光科技分部资料

图表354 2013-2015财年美光科技收入分地区资料

图表355 2014-2016财年美光科技综合收益表

图表356 2014-2016财年美光科技分部资料

图表357 2014-2016财年美光科技收入分地区资料

图表358 2014-2015财年安华高科技综合收益表

图表359 2015-2016财年博通有限公司综合收益表

图表360 2015-2016财年博通有限公司分部资料

图表361 2015-2016财年博通有限公司收入分地区资料

图表362 2014-2015财年英飞凌科技综合收益表

图表363 2014-2015财年英飞凌科技分部资料

图表364 2014-2015财年英飞凌科技收入分地区资料

图表365 2015-2016财年英飞凌科技综合收益表

图表366 2015-2016财年英飞凌科技分部资料

图表367 2015-2016财年英飞凌科技收入分地区资料

图表368 2014-2015年台积电综合收益表

图表369 2014-2015年台积电分部资料

图表370 2014-2015年台积电分产品资料

图表371 2014-2015年台积电收入分地区资料

图表372 2015-2016年台积电综合收益表

图表373 2015-2016年台积电分部资料

图表374 台积电先进制造布局

图表375 2015年纯代工晶圆制造销售规模

图表376 2015-2016年全球先进纯代工晶圆制造市场规模增长情况

图表377 2014-2015年日月光综合收益表

图表378 2014-2015年日月光分部资料

图表379 2014-2015年日月光收入分地区资料

图表380 2015-2016年日月光综合收益表

图表381 2015-2016年日月光分部资料

图表382 2014-2015年联华电子综合收益表

图表383 2015-2016年联华电子综合收益表

图表384 2014-2015年联电各制程节点营收比重

图表385 2014-2015年华虹半导体综合收益表

图表386 2014-2015年华虹半导体分部资料

图表387 2014-2015年华虹半导体收入分地区资料

图表388 2015-2016年华虹半导体综合收益表

图表389 2015-2016年华虹半导体收入分地区资料

图表390 2013-2014年中芯国际综合收益表

图表391 2013-2014年中芯国际收入分地区资料

图表392 2014-2015年中芯国际综合收益表

图表393 2014-2015年中芯国际分部资料

图表394 2014-2015年中芯国际收入分地区资料

图表395 2015-2016年中芯国际综合收益表

图表396 2015-2016年中芯国际收入分地区资料

图表397 2014-2016年杭州士兰微电子股份有限公司总资产和净资产

图表398 2014-2015年杭州士兰微电子股份有限公司营业收入和净利润

图表399 2016年杭州士兰微电子股份有限公司营业收入和净利润

图表400 2014-2015年杭州士兰微电子股份有限公司现金流量

图表401 2016年杭州士兰微电子股份有限公司现金流量

图表402 2015年杭州士兰微电子股份有限公司主营业务收入分行业、产品、地区

图表403 2014-2015年杭州士兰微电子股份有限公司成长能力

图表404 2016年杭州士兰微电子股份有限公司成长能力

图表405 2014-2015年杭州士兰微电子股份有限公司短期偿债能力

图表406 2016年杭州士兰微电子股份有限公司短期偿债能力

图表407 2014-2015年杭州士兰微电子股份有限公司长期偿债能力

图表408 2016年杭州士兰微电子股份有限公司长期偿债能力

图表409 2014-2015年杭州士兰微电子股份有限公司运营能力

图表410 2016年杭州士兰微电子股份有限公司运营能力

图表411 2014-2015年杭州士兰微电子股份有限公司盈利能力

图表412 2016年杭州士兰微电子股份有限公司盈利能力

图表413 2014-2016年江苏长电科技股份有限公司总资产和净资产

图表414 2014-2015年江苏长电科技股份有限公司营业收入和净利润

图表415 2016年江苏长电科技股份有限公司营业收入和净利润

图表416 2014-2015年江苏长电科技股份有限公司现金流量

图表417 2016年江苏长电科技股份有限公司现金流量

图表418 2015年江苏长电科技股份有限公司主营业务收入分行业、产品、地区

图表419 2014-2015年江苏长电科技股份有限公司成长能力

图表420 2016年江苏长电科技股份有限公司成长能力

图表421 2014-2015年江苏长电科技股份有限公司短期偿债能力

图表422 2016年江苏长电科技股份有限公司短期偿债能力

图表423 2014-2015年江苏长电科技股份有限公司长期偿债能力

图表424 2016年江苏长电科技股份有限公司长期偿债能力

图表425 2014-2015年江苏长电科技股份有限公司运营能力

图表426 2016年江苏长电科技股份有限公司运营能力

图表427 2014-2015年江苏长电科技股份有限公司盈利能力

图表428 2016年江苏长电科技股份有限公司盈利能力

图表429 2014-2016年吉林华微电子股份有限公司总资产和净资产

图表430 2014-2015年吉林华微电子股份有限公司营业收入和净利润

图表431 2016年吉林华微电子股份有限公司营业收入和净利润

图表432 2014-2015年吉林华微电子股份有限公司现金流量

图表433 2016年吉林华微电子股份有限公司现金流量

图表434 2015年吉林华微电子股份有限公司主营业务收入分行业、产品、地区

图表435 2014-2015年吉林华微电子股份有限公司成长能力

图表436 2016年吉林华微电子股份有限公司成长能力

图表437 2014-2015年吉林华微电子股份有限公司短期偿债能力

图表438 2016年吉林华微电子股份有限公司短期偿债能力

图表439 2014-2015年吉林华微电子股份有限公司长期偿债能力

图表440 2016年吉林华微电子股份有限公司长期偿债能力

图表441 2014-2015年吉林华微电子股份有限公司运营能力

图表442 2016年吉林华微电子股份有限公司运营能力

图表443 2014-2015年吉林华微电子股份有限公司盈利能力

图表444 2016年吉林华微电子股份有限公司盈利能力

图表445 2014-2017年全球半导体市场按国别投资规模

图表446 2014-2016年中国半导体投资额

图表447 2014年至今大陆存储行业投资规模

图表448 2014年大陆生产封测行业投资规模

图表449 2014年大陆模拟芯片行业投资规模

图表450 2014年大陆芯片生产设备行业投资规模

图表451 2014年大陆SOC数字芯片行业投资规模

图表452 半导体全产业链示意图

图表453 1996-2014年半导体全球半导体销售额趋势图

图表454 半导体产品的主要分类

图表455 “《中国制造2025》技术路线图”的集成电路产业设备国产化目标

图表456 2015年中国前十大半导体设备厂商销售收入

图表457 2015-2017年中国半导体晶圆制造厂开工建设计划

图表458 2015年全球前十大晶圆厂营收情况及市占率

图表459 集成电路前道工艺主要设备及相应供应商

图表460 中国多款设备进入28纳米晶圆制造生产线

详细请访问：<https://www.huaon.com/detail/320011.html>